江苏中科智芯集成科技有限公司

招 聘 简 章

江苏中科智芯集成科技有限公司（以下简称“中科智芯”或“公司”）作为江苏省徐州市落实国家打造淮海经济商区中心城市集成电路与 ICT 产业基地的典型，于 2018 年 3 月 22 日在江苏徐州经济技术开发区注册成立。

公司位于徐州经济技术开发区凤凰电子信息产业园，占地约 53 亩，投资近 20 亿元，项目分两期建设。第一阶段建筑面积共计约为 12000 平方米，其中净化生产面积近 4000 平方米，建成后将可形成年生产加工 12 万片 12 寸晶圆的产能，二期项目规划总建筑面积约 3 万平方米。全年投产后产能将增长到年产 100 万片 12 寸晶圆。

公司由具有国际知名企业和研发机构长期技术与管理经验、入选国家“千人计划”、江苏省“双创”领军人才和具有丰富研发经验的本土团队相结合核心团队。 团队成员具有在国际先进半导体企业的工作经验，在半导体先进封装领域，如扇出、扇入、芯片倒装、堆叠封装、硅通孔等高顶端领域都有着丰富的经验，拥有多项自主知识产权。作为集成电路先进封装研发与生产代工基地，公司产品/技术定位于：凸晶(点) /微凸点（bumping /micro-bumping）、晶圆级芯片封装 (wafer level chip scale packaging, WLCSP)、扇出型封装（fanout wafer level packaging, FOWLP)、三维堆叠与系统集成封装（3D packaging & system-in-packaging, SiP)，为半导体封装/测试提供先进生产技术与系统解决方案，成为国内著名的集成电路封测企业。

招 聘 需 求 表				
序号	岗位名称	学历	要求	人数
1	封装设计工程师	本科及以上	微电子、集成电路设计与集成系统等相关专业；熟练掌握 cadence APD/SIP，mentor、AutoCAD 等工具；	8

2	Mask 绘图设计	本科以下	机械、电子相关专业；熟悉 AutoCAD，office 等办公软件的使用；	3
3	PIE 工程师	本科及以上	物理，化学，材料，微电子等相关专业；熟悉 WLCSP、bumping、Fan Out 和 DPS 工艺流程或者相关的工艺模块；	5
4	NPI 工程师	本科及以上	半导体、微电子、材料、化学、高分子等相关专业；熟练运用 office，AutoCAD 等软件，可看懂封装图纸；熟悉了解 Bumping/WLCSP/Fan Out/CIS 等封装工艺；	8
5	助理工程师	本科及以上	机械、电子等相关专业；	10
6	技术员	本科以下	专业不限；良好的理解能力及沟通能力；	15
7	市场助理	本科及以上	专业不限；熟练使用 office 软件；英语四级以上	5

福利待遇：

1、优厚的薪资待遇，双休、法定节假日、带薪年假；

2、入职即缴纳五险一金，餐补，交补，月、年度奖金，年工补贴，职称津贴，节日福利，定期活动及员工旅游等各项福利。

联系方式：

电话：13357958892（微信号码）

邮箱：peiwenxin@casmeit.com　cuiying@casmeit.com

地址：徐州市经济开发区创业路 26 号凤凰湾电子产业园 101 厂房